

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年3月27日(27.03.2025)



(10) 国際公開番号
WO 2025/063041 A1

(51) 国際特許分類:
G03F 7/038 (2006.01) *G03F 7/004* (2006.01)
C08G 59/46 (2006.01) *G03F 7/037* (2006.01)
C08G 73/10 (2006.01) *H05K 1/03* (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2024/031656

(22) 国際出願日: 2024年9月4日(04.09.2024)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2023-156681 2023年9月22日(22.09.2023) JP

(71) 出願人: 東レ株式会社 (TORAY INDUSTRIES, INC.) [JP/JP]; 〒1038666 東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 加藤 圭悟 (KATO Keigo); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 松村 和行 (MATSUMURA Kazuyuki); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 楯岡 佳子 (TATEOKA Yoshiko); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN,

CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: NEGATIVE PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION, NEGATIVE PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION COATING FILM, NEGATIVE PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION FILM, CURED FILM, AND ELECTRONIC COMPONENT USING SAME

(54) 発明の名称: ネガ型感光性樹脂組成物、ネガ型感光性樹脂組成物被膜、ネガ型感光性樹脂組成物フィルム、硬化膜、およびこれらを用いた電子部品

(57) Abstract: This negative photosensitive resin composition comprises cationically polymerizable compound as a component (A), and a photocationic polymerization initiator as a component (B), wherein the component (A) contains, as a component (A1), a polyfunctional aromatic glycidyl ether having an epoxy equivalent of 80-145 g/eq and having at least two epoxy groups in a molecule, with the content of the component (A1) in the entirety of the component (A) being 45%-100% by mass. Provided is a negative photosensitive resin composition which is preferably used for adhesion of a semiconductor element or electronic component and which achieves both excellent resolution and adhesiveness.

(57) 要約: (A) 成分としてカチオン重合性化合物、(B) 成分として光カチオン重合開始剤を含有するネガ型感光性樹脂組成物であって、前記(A)成分が、(A1)成分としてエポキシ当量が80~145 g/eqであり、かつ分子内に少なくとも2つ以上のエポキシ基を有する多官能芳香族グリシジルエーテルを含有し、前記(A)成分全体に占める前記(A1)成分の含有量が、45~100質量%である、ネガ型感光性樹脂組成物。半導体素子や電子部品の接着用途に好適な、優れた解像性と接着性を両立するネガ型感光性樹脂組成物を提供する。

WO 2025/063041 A1